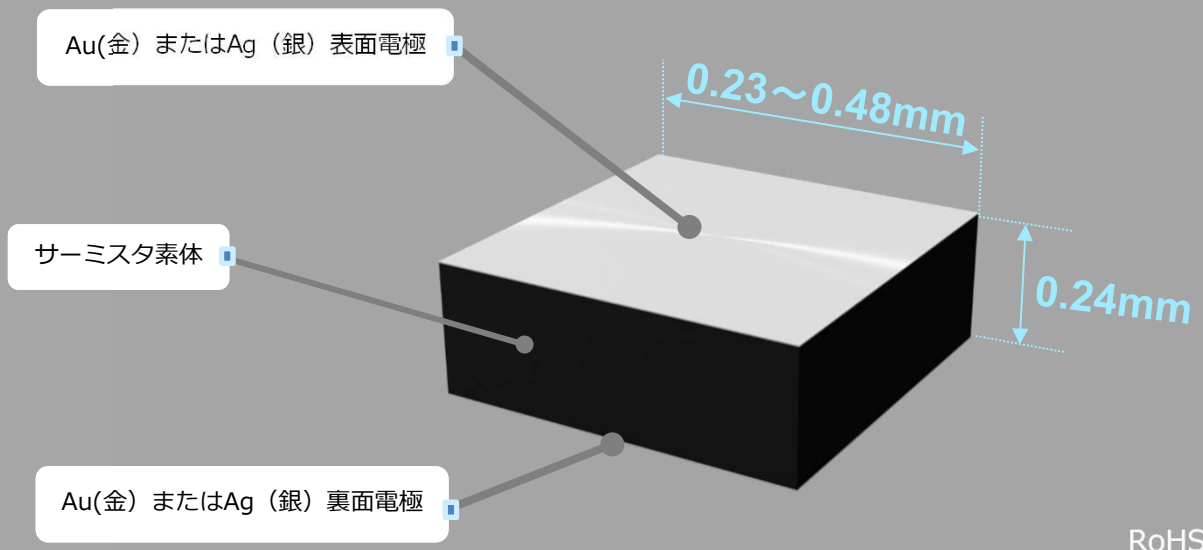
開発中製品

https://www.tateyama.jp/dt

高温耐熱＆高精度＆超小型

２００℃高温耐熱ワイヤボンディング用超小型サーミスタ



RoHS指令準拠

特長

- ☐ SiC・GaNの高温動作に対応したワイヤボンディング用NTCサーミスタです。
- ☐ 表面電極は用途に合わせてAu（金）またはAg（銀）から選択することができます。
- ☐ 独自の調合法により、お客様のご要望に合わせた抵抗値とB定数に調整することができます。
- ☐ 超小型タイプのため、実装基板の薄型化に貢献します。
- ☐ 熱応答性が高く、熱容量が小さいため、温度変化に対して迅速に反応します。
- ☐ 高精度な温度測定、温度補償、温度調整など幅広い用途に使用可能です。
- ☐ AEC-Q200にも対応可能です。

アプリケーション

- ■ 光通信モジュール / 光トランシーバーモジュール
- ■ LiDAR
- ■ LEDやLDヘッドライト
- ■ IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）
- ■ EV / HEV 向けインバーター
- ■ GPUや半導体、電子部品の温度補償
- ■ MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）の温度補償
- ■ ABS制御回路

製品の特性はお客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

仕様

チップサイズ	使用温度範囲	抵抗値(25℃)	抵抗値許容差	B定数 (25℃/85℃)	B定数公差	電極
L・W:0.23mm ±0.05mm T:0.24mm ±0.05mm	-40℃ ～ +200°C	29kΩ	±1%~3%	3960K	±1%	Au（金）/Ag（銀）
L・W:0.34mm ±0.05mm T:0.24mm ±0.05mm		32kΩ				
L・W:0.46mm ±0.05mm T:0.24mm ±0.05mm		58kΩ				
L・W:0.48mm ±0.05mm T:0.24mm ±0.05mm		127kΩ				

© 2025 株式会社立山科学デバイステクノロジー